

Termin- und Themenplan 2026 / Änderungen vorbehalten

Ausgabe	März	Juni	Englisch	September	November
Redaktionsschluss	06.02.26	30.03.26	15.06.26	06.07.26	04.09.26
Anzeigenschluss	20.02.26	17.04.26	10.07.26	24.07.26	25.09.26
Erscheinungstermin	23.03.26	01.06.26	24.08.26	01.09.26	02.11.26
	SIAMS, Moutier/CH, 21.-24.04.26 Hannover Messe, Hannover, 20.-24.04.26 Control Expert Days, Stuttgart, 20.+21.05.26 Optatec, Frankfurt a.M, 05.-07.05.26 Rapid.Tech 3D, Erfurt, 05.-07.05.26 MedtecLIVE, Stuttgart, 05.-07.05.26 GrindingHUB, Stuttgart, 05.-08.05.26 Make-to-Order Days, Stuttgart, 09.-10.06.26 Sensor+Test, Nürnberg, 09.-11.06.26 PCIM, Nürnberg, 09.-11.06.26 EPHJ, Genf/CH, 16.-19.06.26 Actuator, 30.06.-01.07.26, Wiesbaden Länderspecial: Schweiz		AMB, Stuttgart, 15.-19.09.26 ECOC, Malaga/ES, 21.-23.09.26 Micronora, Besançon/FR, 29.09-02.10.26 Semicon Europe, München, 18.-21.11.26 Precision Fair, s-Hertogenbosch/NL, 18.+19.11.26 u.w.m. in 2026 und 2027	AMB, Stuttgart, 15.-19.09.26 W3+ Fair, Jena, 23.+24.09.26 Motek/Bondexpo, Stuttgart, 06.-08.10.26 EPX, Stuttgart, 06.-08.10.26 Fakuma, Friedrichshafen, 12.-16.10.26 EuroBLECH, Hannover, 20.-23.10.26 preXcon, St. Gallen/CH, 03.-05.11.26 Sonderthema: Reinheitstechnik	ComPaMED, Düsseldorf, 16.-19.11.26 Formnext, Frankfurt a.M., 17.-20.11.26 Precision Fair, s-Hertogenbosch/NL, 18.+19.11.26 Electronica, München, 18.-21.11.26 Semicon Europe, München, 18.-21.11.26 SPS, Nürnberg, 24.-26.11.26
	FOKUSTHEMEN: Mikromontage / AVT Messtechnik	FOKUSTHEMEN: Lasertechnik Mikropositionierung	International Supplier Database	FOKUSTHEMEN: Mikrozerspanung Mikrospritzgießen	FOKUSTHEMEN: Elektronikfertigung Mikrostrukturtechnik
Industrie 4.0: Digitalisierung, Internet of Things, Sensorintegration und -netzwerke, Simulation, KI	●	●	●	●	●
Mikro- und Nanopositioniersysteme: Linear-, Rund- und Kreuztische, Piezoaktoren, Kleinstantriebe, Maschinengestelle, Motion Control	●	●	●	●	●
Mikrolaserbearbeitung: Laserschneiden, -schweißen, -bohren, -strukturieren, -markieren	●	●	●	●	●
Mechanische Mikrobearbeitung: Mikrofräsen, -drehen, -bohren, -schleifen, Ultraschallbearbeitung	●	●	●	●	●
Mikroumformtechnik: Mikrostanzen, -biegen, Mikromassivumformung, Hybridtechnik	●				●
Mikrofunkenerosion: Senk- und Drahterosion		●	●	●	
Ultrapräzisionsbearbeitung: Diamantdrehen und -fräsen, Freiformoptik	●	●	●	●	●
Mikrospritzgießen: Spritzgießtechnik, Einspritzmodule, PIM, CIM, 3D-MID, 2K, Heißkanaltechnik	●	●	●	●	●
Mikrostrukturtechnik: LIGA, Galvanoformung, Heißprägen, Prägelithografie, Nanoimprint etc.	●	●	●	●	●
Halbleitertechnik: Lithografie, Ätzen, Mask-Alignment, Wafer-Stepper, Spincoater		●	●		●
Aufbau- und Verbindungstechnik: Bonden, Flip-Chip, 3D-Integration, Mikrolöten, -schweißen, -kleben, Mikrodispensen, Widerstandsschweißen	●	●	●	●	●
Mikromontage: Mikro- und Nanorobotik, Mikrogreifer, Magazinierung, Zuführung	●	●	●	●	●
Additive Fertigung: Pulverbett- und Extrusionsverfahren, Jetting, Photo Polymerisation, Werkstoffe	●	●	●		●
Elektrochemische Mikrobearbeitung, Feinätzen	●		●		●
Messtechnik: Optische und taktile Messtechnik, Mikroskopie, Elektronenmikroskopie, Tomografie, Längen- und Winkelmesstechnik, Bildverarbeitung	●	●	●	●	●
Spanntechnik: Magnet-, Gefrier- und Vakuumspanntechnik, Spannstöcke, Nullpunktspanner	●		●	●	
Oberflächentechnik: Nanobeschichtung, Nanotechnologie, Plasmatechnik	●	●			●
Reinheitstechnik: Rein- und Trockenraumtechnik inkl. -ausstattung, Klimatisierung, Bauteilreinigung	●	●	●	●	●
Mikrowasserstrahlschneiden		●	●	●	
Mikrokomponenten und -systeme: MEMS, Energy Harvesting, Mikropumpen, -sensoren, -batterien	●	●	●	●	●